

2016年12月13日

エスアイアイ・セミコンダクタ:「第3回ウェアラブル EXPO」出展のお知らせ

セイコーインスツル株式会社(社長:村上 斉、本社:千葉県千葉市)の子会社で、半導体の製造・販売を行うエスアイアイ・セミコンダクタ株式会社(社長:石合 信正、本社:千葉県千葉市、以下:エスアイアイ・セミコンダクタ)は、2017年1月18日(水)~1月20日(金)に開催される「第3回 ウェアラブル EXPO -ウェアラブル端末の活用と技術の総合展-」(会場:東京ビッグサイト)に出展します。



ウェアラブル EXPO では、業務改善のためのウェアラブルソリューションから、IoT、AR/VR 技術、最新ウェアラブルデバイス開発のための部品・材料まで、ウェアラブルに関する製品・技術が展示されます。当社ブースでは、エネルギーハーベストによるクリーンなエネルギーでウェアラブル機器を実現するソリューションと半導体製品をデモを交えてご紹介します。

【展示会情報】

- ・展示会名: 第3回 ウェアラブル EXPO -ウェアラブル端末の活用と技術の総合展-
- ・会期: 2017年1月18日[水]~20日[金]
- ・会場: 東京ビッグサイト 西ホール 2階 開発技術ゾーン
- ・小間番号: W21-13
- ・URL: <http://www.wearable-expo.jp/>

【出展内容】

1.電池のいらぬウェアラブル

エネルギーハーベスティング技術を応用したソリューションをご提案します。

- ・CLEAN_アグローブ： 土壤発電を利用し、「周辺環境および土壤の状態を見える化」するグローブ
- ・CLEAN_サンバイザ： 1セル太陽電池により紫外線(UV)センサおよび脳波センサを駆動するサンバイザ
- ・CLEAN_エコマウス： 温度差と磁歪(クリック動作)のハイブリッド発電により駆動するワイヤレスマウス
- ・CLEAN_アセパッチ： バイオ発電による発汗センサ

2.ウェアラブル/IoT 向け 電源 IC・センサ

ウェアラブル機器に最適な電源 IC、センサを紹介します。

【製品・技術セミナー】

- ・タイトル： 電池のいらぬクリーンウェアラブルへの挑戦
- ・概要： あらゆるエネルギー源を活用したハーベスティングを実現！
時計省電力技術で培った電池のいらぬ無線半導体ソリューションを提供
- ・セミナー日時： 1月20日(金) 13:30~14:00
- ・セミナー会場： 展示会場内 特別スペース

【Web サイト】

<http://www.sii-ic.com/jp/semicon/>

以上

【本件に関するお問い合わせ】

〔報道関係〕

セイコーインスツル株式会社
経営管理部 広報課 荒井、森
TEL : 043-211-1185 MAIL : pr@sii.co.jp

〔一般のお客様〕(紙面などの掲載時はこちらでお願いします)

エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社
営業本部
TEL : 043-211-1193
URL : <http://www.sii-ic.com>